

金属(Sn)の昇温脱離ガス分析

低融点金属のTDS分析

測定法 : TDS
 製品分野 : 製造装置・部品
 分析目的 : 組成評価・同定・昇温による脱ガス評価

概要

スズは半導体の製造でも使用されるはんだの主原料として用いられています。はんだ中のガスはボイド発生の原因となるため、はんだやその主原料であるスズの内包ガス量を制御することが重要です。TDS分析にてスズが融解する際の脱ガスについて調査した結果を以下に示します。
 TDSでは昇温と共に、金属の表面吸着成分や内包ガスの成分について評価することが可能です。

データ

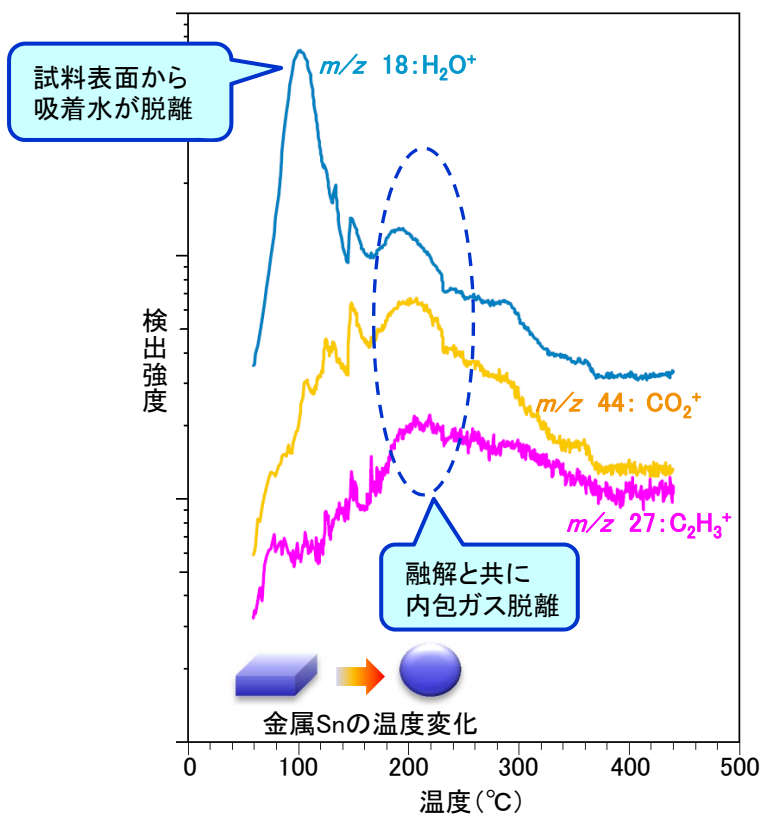


図1 SnのTDS分析結果

表1 定量値算出結果

m/z	18(H ₂ O)	44(CO ₂)
分子の個数(Sn 100mgあたり)	4.6E+16	4.3E+15
試料中の濃度(μg/g)	13	3.0

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！